

2018-2024年中国晶圆制造 市场深度研究与市场供需预测报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2018-2024年中国晶圆制造市场深度研究与市场供需预测报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/201807/25-268414.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

我国近年大力发展晶圆制造业。2017~2020年全球计划兴建晶圆厂62座，其中26座将落户中国，占比达到40%全球规划建设晶圆厂数量

中国产业研究报告网发布的《2018-2024年中国晶圆制造市场深度研究与市场供需预测报告》共十上章。首先介绍了中国 晶圆制造行业市场发展环境、 晶圆制造整体运行态势等，接着分析了中国 晶圆制造行业市场运行的现状，然后介绍了 晶圆制造市场竞争格局。随后，报告对 晶圆制造做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国 晶圆制造行业发展趋势与投资预测。您若想对 晶圆制造产业有个系统的了解或者想投资中国 晶圆制造行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 晶圆制造简介 21

第一节 晶圆制造流程 21

第二节 晶圆制造成本分析 27

第二章 2017年半导体市场 32

第一节 2017年半导体产业分析 32

第二节 2017年半导体市场上下游状况分析 34

第三节 2017年全球晶圆制造产业现状 35

第四节 2017年全球半导体制造产业 38

一、全球半导体产业概况 38

二、全球晶圆制造行业概况 39

第五节 2017年中国半导体产业与市场 44

一、中国半导体市场 44

二、中国半导体产业 47

三、中国IC设计产业 56

四、中国半导体产业发展趋势 59

第三章 2017年晶圆制造产业简介 61

第一节 晶圆制造工艺简介 61

第二节 全球晶圆产业及主要厂商简介 62

全球晶圆制造企业排名	排名	公司	地区
2016营收（百万美元）	同比		1
台积电	台湾	29488	11%
2	格罗方德	美国	5545
10%	3	联电	台湾
4582	3%	4	中芯国际
大陆	2921	31%	5
Powerchip	台湾	1275	1%
6	TowerJazz	台湾	1249
30%	7	Vanguard	台湾
800	9%	8	华虹半导体
大陆	712	10%	9
Dongbu HiTek	韩国	672	13%
10	X-Fab	欧洲	510
54%			

第三节 中国半导体产业政策环境 70

第四节 中国晶圆制造业现状及预测 73

第四章 2017年晶圆制造行业主要企业分析 76 (ZY GXH)

一、中芯国际 76

(一) 企业偿债能力分析 77

(二) 企业运营能力分析 79

(三) 企业盈利能力分析 82

二、上海华虹NEC电子有限公司 83

(一) 企业偿债能力分析 85

(二) 企业运营能力分析 87

(三) 企业盈利能力分析 90

三、上海宏力半导体制造有限公司 92

(一) 企业偿债能力分析 93

- (二) 企业运营能力分析 95
- (三) 企业盈利能力分析 98
- 四、华润微电子 99
 - (一) 企业偿债能力分析 100
 - (二) 企业运营能力分析 102
 - (三) 企业盈利能力分析 105
- 五、上海先进半导体 106
 - (一) 企业偿债能力分析 107
 - (二) 企业运营能力分析 109
 - (三) 企业盈利能力分析 112
- 六、和舰科技(苏州)有限公司 113
 - (一) 企业偿债能力分析 114
 - (二) 企业运营能力分析 116
 - (三) 企业盈利能力分析 119
- 七、BCD(新进半导体)制造有限公司 120
 - (一) 企业偿债能力分析 121
 - (二) 企业运营能力分析 123
 - (三) 企业盈利能力分析 126
- 八、方正微电子有限公司 127
 - (一) 企业偿债能力分析 128
 - (二) 企业运营能力分析 130
 - (三) 企业盈利能力分析 133
- 十、南通绿山集成电路有限公司 134
 - (一) 企业偿债能力分析 135
 - (二) 企业运营能力分析 137
 - (三) 企业盈利能力分析 140
- 十一、纳科(常州)微电子有限公司 141
 - (一) 企业偿债能力分析 144
 - (二) 企业运营能力分析 146
 - (三) 企业盈利能力分析 149
- 十二、珠海南科集成电子有限公司 150
 - (一) 企业偿债能力分析 151

- (二) 企业运营能力分析 153
- (三) 企业盈利能力分析 156
- 十三、康福超能半导体(北京)有限公司 157
 - (一) 企业偿债能力分析 157
 - (二) 企业运营能力分析 159
 - (三) 企业盈利能力分析 162
- 十四、科希-硅技半导体技术第一有限公司 163
 - (一) 企业偿债能力分析 163
 - (二) 企业运营能力分析 165
 - (三) 企业盈利能力分析 168
- 十五、光电子(大连)有限公司 170
 - (一) 企业偿债能力分析 170
 - (二) 企业运营能力分析 172
 - (三) 企业盈利能力分析 175
- 十六、西安西岳电子技术有限公司 176
 - (一) 企业偿债能力分析 177
 - (二) 企业运营能力分析 179
 - (三) 企业盈利能力分析 182
- 十七、吉林华微电子股份有限公司 183
 - (一) 企业偿债能力分析 185
 - (二) 企业运营能力分析 187
 - (三) 企业盈利能力分析 190
- 十八、丹东安顺微电子有限公司 191
 - (一) 企业偿债能力分析 191
 - (二) 企业运营能力分析 193
 - (三) 企业盈利能力分析 196
- 十九、敦南科技 198
 - (一) 企业偿债能力分析 199
 - (二) 企业运营能力分析 200
 - (三) 企业盈利能力分析 203
- 二十、福建福顺微电子 205
 - (一) 企业偿债能力分析 206

(二) 企业运营能力分析	208
(三) 企业盈利能力分析	211
二十一、杭州立昂	212
(一) 企业偿债能力分析	213
(二) 企业运营能力分析	215
(三) 企业盈利能力分析	218
二十二、杭州士兰集成电路	219
(一) 企业偿债能力分析	220
(二) 企业运营能力分析	222
(三) 企业盈利能力分析	224
二十三、HYNIX-ST半导体公司	226
(一) 企业偿债能力分析	226
(二) 企业运营能力分析	228
(三) 企业盈利能力分析	231 (ZY GXH)

图表目录：

图表1 晶圆制造工艺流程	21
图表2 晶圆尺寸变化影响加工成本趋势分析	27
图表3 2017年度全球营收前13的晶圆制造企业	35
图表4 2018-2024年大陆IC内需市场规模变化与预测	36
图表5 主要代工企业产能分布及收益情况	41
图表6 集成电路技术节点及其对应研发和建厂费用	43
图表7 全球半导体市场规模超过3000亿美元	47
图表8 半导体产品种类繁多	48
图表9 全球半导体分产品市场占比	48
图表10 中国大陆半导体市场规模近4000亿元	49
图表11 全球半导体产业区域结构发生巨大变化	50
图表12 北美半导体设备制造商bb 值	51
图表13 半导体产业链	51
图表14 近期或者未来有望在A股上市的半导体厂商	52
图表15 半导体产业链上封测环节技术壁垒相对较低	53
图表16 封测环节在半导体产业链中的相对进入壁垒	54

- 图表17 集成电路封测行业一直占据行业主导地位 55
- 图表18 国内十大半导体封装测试企业 56
- 图表19 2017年全球晶圆制造排名 63
- 图表20 2017年全球前三大半导体厂商营收与成长趋势 64
- 图表21 全球半导体厂商资本支出占营收比例之比较 65
- 图表22 前三大半导体厂商资本支出与占营收比例趋势 66
- 图表23 全球半导体厂商资本支出集中程度分析 67
- 图表24 半导体设备厂商于18寸晶圆生产设备投资考虑情境分析 68
- 图表25 全球半导体设备产业版图的变化 69
- 图表26 国内政策对集成电路产业大力支持 71
- 图表27 国内半导体进口金额超2000亿美元 71
- 图表28 国内集成电路未来三阶段发展目标 73

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R06/R0601/201807/25-268414.html>